









Таблица 1 – Параметры и порядок размещения слоев печатной платы

Материал	Слой	Толщина, мм		
PSR-4000 H85	Маска верхнего слоя	0,01		
Медь	Верхний проводниковый слой	0,0175		
Npenpez FR-4	Слой диэлектрика	1,545		
Медь	Нижний проводниковый слой	0,0175		
PSR-4000 H85	Маска нижнего слоя	0,01		

Расчетная толщина ПП: 1,6 мм

Финальная толщина ПП: 1,6 мм ± 10%

- 1. \* Размеры для справок.
- 2. Шаг координатной сетки 1 мм.
- 3. Изготовить комбинированным позитивым методом по ОСТ 5.9707-88.
- 4. Класс точности печатной платы 3 ГОСТ 23751–86.
- 5. Плата должна соответствать ГОСТ 23752-79. Группа жесткости 3.
- 6. Ширина проводников не менее 0.3 мм.
- 7. Расстояние между проводниками не менее 0.3 мм.
- 8. Остальные ТТ по ГОСТ Р 55693-2013

<u>8. UCMO</u>	ЛЬНЫЕ ІІГ	<u> 10   UL  </u>	P 5	5693-2013.					
				CM7.					
					/	/lum. Macca Macu			Масш.
Изм Лист		Подп.	Дата		П				
Разраб	Москвитин Д.Д	ļ.		Плата управления	Н				1:1
Пров.	Бошляков А.А.			Tindina gripaonenan	Ш				
Т.контр.						/lucm	1	/1ເ	JCШ0В
Н.контр Утв.				Плата печатная	МГТУ им. Н.Э. Баумана группа СМ7–71Б				